



第6回研究会

3DHIアライアンス第6回研究会

-チップレットデザインと信頼性に関する最新情報-

- 12:45 **開場**
- 13:00 ~ 13:45 **「エッジAIセンシングプラットフォーム「AITRIOS™」で実現する社会課題の解決とその導入事例」**
ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社 システムソリューション事業部
プラットフォームコア開発2部 担当部長 浴 良仁 氏
- 13:45 ~ 14:30 **「先端SoCチップレットの技術動向とルネサスの取り組みについて」**
ルネサスエレクトロニクス株式会社 ハイパフォーマンスコンピューティングプロダクトグループ
HPCマーケティング統括部 技師長 原 博隆 氏
- 14:30 ~ 15:00 **「SQIE(半導体・量子集積エレクトロニクス研究センター) のアップデート」と
「横浜国立大学総合学術高等研究院よりのお知らせ」**
3DHI代表 井上 史大 氏
横浜国立大学 総合学術高等研究院 研究戦略企画マネージャー 河野 浩之 氏
- 15:00 ~ 15:15 **休憩**
- 15:15 ~ 16:00 **「配線の信頼性物理と寿命の統計学」**
電気通信大学 i-パワードエネルギー・システム研究センター
センター長・教授 横川 慎二 氏
- 16:00 ~ 16:45 **「BBCube™ Large-Scale 3DI using WOW/COW Hybrid Processes」**
東京工業大学 科学技術創成研究院 教授 大場 隆之 氏
- 17:00 ~ 19:00 **「情報及び名刺交換会」(お申込みされた方のみ)**